
中泰证券股份有限公司
关于北京赛微电子股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金
继续用于子公司项目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微电子”）2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目进行了审慎核查，核查情况如下：

一、部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的概述

因公司2021年向特定对象发行股票募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”已达到预定可使用状态，鉴于公司此前于2023年12月14日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，增加北京海创微元科技有限公司（以下简称“海创微元”）为该募投项目实施主体，同时增加怀柔区怀柔科学城为该募投项目实施地点，该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过；公司于2024年2月6日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的议案》，同意公司使用12,600万元募集资金向控股子公司海创微元出资，用于募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”的建设。因此公司拟将海创微元该部分节余募集资金继续用于MEMS中试线建设，该中试线可持续进行与该募投项目相关工艺及业务的后续迭代研发，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680号文核准，2021年公司向特定对象发行人民币普通股90,857,535股，发行价格为25.81元/股，募集资金总额为人民币2,345,032,978.35元，扣除发行费用11,600,291.50元（不含增值税），募集资金净额为2,333,432,686.85元。

该募集资金已于2021年8月23日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	8英寸MEMS国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98
2	MEMS高频通信器件制造工艺开发项目	32,580.00	32,580.00
3	MEMS先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00
4	补充流动资金	51,791.32	51,791.32
合计		415,203.32	234,503.30

三、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	余额
1	中信银行北京分行	8110701013502121334	9,356.69
2	杭州银行北京分行	1101040160001355881	-
3	宁波银行北京分行	77010122001377768	-
4	宁波银行北京分行	77010122001377977	0.13
5	杭州银行北京分行	1101040160001356145	807.41
6	杭州银行北京分行	1101040160001416204	37.29
7	宁波银行北京分行	77180122000035187	10.53
8	民生银行北京分行	688026787	12,620.13
合计			22,832.18

四、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额	募集资金累计投入金额
1	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98	79,051.98	79,289.60
2	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	32,580.00	32,580.00	14,580.00	1,180.00
3	MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00	71,080.00	66,163.34
4	补充流动资金	51,791.32	51,791.32	68,631.29	68,562.23
合计		415,203.32	234,503.30	233,343.27	215,195.17

注：公司于 2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将用于“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元永久补充流动资金；该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”、“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”实施进度进行调整，其中，“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

五、本次结项募投项目实施情况及募集资金使用、结余情况

（一）本次结项募投项目实施情况

1、本次结项募投项目实施内容

为适应 MEMS 产业发展趋势以及公司自身发展战略需要，公司开展了面对高频通信 MEMS 器件制造工艺开发研究活动，依托现有 MEMS 制造能力基础，尽快在高频通信领域前瞻性重点积累工艺技术，推动高频通信及终端应用的 MEMS 器件产品的国产化替代及产业规模化发展，开展了对应用于高频通信的 MEMS 器件和多 MEMS 器件的晶圆级异质异构集成工艺技术的攻关研究。这包括分别对特殊压电薄膜沉积技术、TSV（硅通孔）技术、晶圆级永久键合技术等关键工艺技术的研究。

2、实施该募投项目取得的技术成果

通过实施该募投项目取得的主要技术成果如下：

- （1）基于 2 类不同压电材料，研发了特殊压电薄膜沉积技术；

(2)开发出应用于厚硅晶圆衬底的 TSV 技术;进一步研发获取了相应的 2.5D 晶圆级异构集成技术;

(3) 实现了多晶圆 (晶圆数大于等于 3) 永久键合技术;

(4) 开发了 2 种临时键合与拆建合技术;

(5) 研发出基于扇外型工艺的高频通信模块晶圆级集成技术;

(6) 成功研发出基于 MEMS 工艺的高频微传输结构制备技术;获取了成套毫米波前端模块的晶圆级异质异构集成技术。

(二) 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

该募投项目实施内容与公司及子公司商业活动相匹配,由公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司(以下简称“赛莱克斯国际”)统筹协调,在项目实施过程中,公司相关子公司在自主开发及商业活动中已成功积累相关工艺,高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作已同步获得开展,相关制造工艺已同步成功解决。除募集资金投入部分外,与该募投项目相关的研发活动也获得日常商业活动及政府补助相关项目的支持,该项目综合所获支持金额高于原计划投入金额。因此,在该募投项目完结时,仍有部分募集资金产生节余。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”已达到预定可使用状态,该募投项目的研发目标均已实现、已取得相关技术成果并在商业活动中进行应用。截至 2024 年 6 月 30 日,该募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	预计待支付款项	节余募集资金金额(含利息收入)
MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	14,580.00	1,180.00	800.00	12,620.13

注:“预计待支付款项”为公司全资子公司赛莱克斯国际尚未支付的合同尾款,后续将继续从对应的募集资金专户中支付,该笔费用支付后,预计赛莱克斯国际与该募投项目相关的募集资金专户中仍有部分利息;“节余募集资金金额”为海创微元募集资金专户中余额。

(三) 本次结项募投项目节余募集资金的主要原因

1、该募投项目由公司全资子公司赛莱克斯国际和控股子公司海创微元共同实施,公司相关子公司在自主开发及商业活动中已成功积累相关工艺,高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作已同步获得开展,相关制造工艺已同步获得成功解决。

2、除募集资金投入部分外,与该募投项目相关的研发活动也获得日常商业

活动及政府补助相关项目的支持，该项目综合所获支持金额高于原计划投入金额。

3、公司在实施该募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了募集资金节余。

六、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

2023年12月14日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，增加海创微元为该募投项目实施主体，同时增加怀柔区怀柔科学城为该募投项目实施地点。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年2月6日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的议案》，同意公司使用12,600万元募集资金向控股子公司海创微元出资，用于募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”的建设。

海创微元为公司募投项目“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”的实施主体之一，因该募投项目已通过公司全资子公司赛莱克斯国际实施完毕，公司拟将对海创微元出资的该部分资金用于海创微元MEMS中试线的建设，该中试线可持续进行与该募投项目相关工艺及业务的后续迭代研发。海创微元的基本情况如下：

1、基本情况

(1) 公司名称：北京海创微元科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110116MAD718NG1H

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 住所：北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号56幢2层210室

(5) 法定代表人：杨云春

(6) 注册资本：30000万人民币

(7) 成立日期：2023年12月22日

(8) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元

器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

海创微元的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
1	北京赛微电子股份有限公司	12,600	42%
2	北京怀胜高科技产业发展有限公司	9,000	30%
3	北京怀柔硬科技创新服务有限公司	3,000	10%
4	北京赛微私募基金管理有限公司	5,400	18%
	合计	30,000	100%

3、中试线基本情况

(1) 名称：MEMS晶圆中试生产线和研发平台。

(2) 投资总额：中试线投资总额为50,000万元，除使用部分节余募集资金投入外，其余所需资金将通过自有或自筹资金解决。

(3) 拟使用节余募集资金投入金额：拟使用节余募集资金12,620.13万元（含利息收入，具体金额以实际使用时银行账户金额为准）。

(4) 建设期间：中试线建设期限预计为36个月。

(5) 建设单位：北京海创微元科技有限公司。

(6) 建设地点：北京市怀柔区怀柔新城0101街区怀柔科学城产业转化示范区。

(7) 投资构成：总投资为50,000万元，其中建设投资46,150万元，铺底流动资金为3,850万元。

七、本次结项募投项目节余募集资金使用计划对公司的影响

鉴于该募投项目已到达预定可使用状态，公司拟将海创微元该部分节余募集资金继续用于其MEMS中试线建设，该中试线建成后，可持续进行与该募投项目相关工艺及业务的后续迭代研发，同时通过提供工艺开发及小批量代工服务，能够更好地为公司旗下的MEMS规模量产线储备并导入相应的客户及产品，有利于促进公司特色工艺晶圆代工业务的发展，从而促进公司MEMS芯片制造业务的进一步发

展，进一步提升公司综合产能、服务能力、行业地位和竞争实力，提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。

八、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》，因公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项并将部分节余募集资金继续用于控股子公司海创微元 MEMS 中试线建设，该中试线可持续进行与该募投项目相关工艺及业务的后续迭代研发。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》，监事会认为：将该募投项目结项并将部分节余募集资金继续用于控股子公司海创微元 MEMS 中试线建设是基于公司经营发展做出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将该募投项目结项并将部分节余募集资金继续用于控股子公司海创微元 MEMS 中试线建设。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议通过，履行了必要的内部审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的事项无异议。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京赛微电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

孙 涛

陈胜可

中泰证券股份有限公司

年 月 日